

## Errata

# CC2755x10 SimpleLink™ ワイヤレス MCU デバイス リビジョン F



## 概要

この文書では、CC2755x10 SimpleLink™ デバイスの機能仕様に対する既知の例外 (アドバイザリ) を説明します。

本文書は、以下のデバイスをサポートしています。

- CC2755R105E0WRHAR
- CC2755P105E0WRHAR
- CC2755R105E0YCJR

## 目次

1 アドバイザリ マトリックス.....	2
2 命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別.....	3
2.1 デバイスおよび開発サポート — ツール命名規則.....	3
2.2 サポート対象デバイス.....	3
2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別.....	3
3 アドバイザリ.....	4

## 商標

SimpleLink™ and テキサス インスツルメンツ™ are trademarks of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 1 アドバイザリ マトリックス

表 1-1 はすべてのアドバイザー、影響を受けるモジュール、および適用可能なシリコン リビジョンを一覧にします。

**表 1-1. アドバイザリ マトリックス**

モジュール	説明	影響を受けるシリコンのリビジョン
		F
ADC	アドバイザー ADC_08 — 反復シングル、シーケンス、および反復シーケンス変換モードで ADC BUSY ビットがクリアされません	あり
ADC	アドバイザー ADC_09 — ADC がランダム変換エラーを発生する可能性があります。	あり
BATMON	アドバイザー BATMON_01 — 温度測定が不正確です	あり
BATMON	アドバイザー BATMON_02 — スタンバイ状態の BATMON から不要な温度更新割り込みが発生します	あり
SYS	アドバイザー SYS_204 — 以前に値がプログラムされている場合、SysTimer が比較イベントを常に生成しないことがあります	あり
SYS	アドバイザー SYS_206 — HFXT 振幅補償および HFXT 振幅制御中に RF 位相がジャンプします	あり
SYS	アドバイザー SYS_207 — FLTSETTLED ビットを早めに読み出すと、スタンバイエントリがゲートされない場合があります	あり
APU	アドバイザー APU_201 — APU データ メモリへの書き込み操作が失敗します	あり
UDMA	アドバイザー UDMA_01 — ペリフェラルからの単一要求に対する $\mu$ DMA 書き込み応答が失われる可能性があります	あり
RADIO	アドバイザー RADIO_05 — Radio の書き込み操作が失敗します	あり

## 2 命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別

### 2.1 デバイスおよび開発サポート ツール命名規則

製品開発サイクルの段階を示すために、テキサス インスツルメンツ™ ではすべての SimpleLink ワイヤレスデバイスの型番に接頭辞を割り当てます。SimpleLink ワイヤレスの各型番には、次の 2 つの接頭辞のいずれかが付いています。CC または XC これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(XC)から、完全認定済みの量産デバイス(CC)までがあります。

デバイスの開発進展フロー:

**XC** 実験的デバイス。最終デバイスの電气的特性を必ずしも表さず、量産アセンブリ フローを使用しない可能性があります。

**CC** 認定済みのシリコン ダイの量産バージョン。

XC デバイスは、次の免責事項付きで出荷されます。

「開発中の製品は、社内での評価用です。」

量産デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ デバイス (X) は、標準的な製品版デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス インスツルメンツではそれらのデバイスを量産システムで使わないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

### 2.2 サポート対象デバイス

本文書は、以下のデバイスをサポートしています。

- CC2755R105E0WRHAR
- CC2755P105E0WRHAR
- CC2755R105E0YCJR

### 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別

パッケージの記号表記 および 表 2-1 はパッケージの記号表記とデバイスのリビジョン コードを説明します。

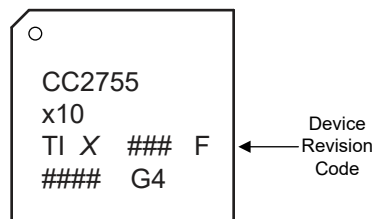


図 2-1. パッケージの記号表記

表 2-1. リビジョンの識別

デバイスリビジョンコード	シリコンのリビジョン
F	PG2.1

デバイスマーキングには、型番 CC2755x が含まれます。ここで、x はデバイスの電力レベルを表します。##### はロットのトレースコードです。オプションとして、TI の文字の後に続く「X」は実験的なデバイスを示します。G4 は環境分類です。

### 3 アドバイザリ

**ADC\_08**                      リピート シングル、シーケンス、および反復シーケンス変換モードでは、**ADC BUSY** ビットがクリアされません。

---

#### 影響を受けるリビジョン F

**説明**                      MEMCTLx レジスタのトリガ ポリシーが「次のトリガ」に設定され、ADC がリピート シングル、シーケンス、または反復シーケンス変換モードで動作している場合、ソフトウェアが **ENC** ビットをクリアして変換シーケンスを停止しようとしても、**STATUS** レジスタの **BUSY** ビットはクリアされません。シーケンス変換モードでトリガ ポリシーが「次のトリガ」に設定されている場合、変換シーケンスの終了時に **BUSY** ビットがクリアされます。

**回避方法**                      上記の ADC 動作シナリオで変換を停止し、**BUSY** ビットをクリアするには、次のソフトウェアシーケンスを実行してください。

1. CTL0.ENC = 0 を書き込みます
2. CTL1.TRIGSRC をソフトウェアに変更します
3. CTL1.SC = 1 を書き込みます

## ADC\_09

## ADC がランダム変換エラーを発生する可能性があります。

### 影響を受けるリビジョン F

#### 説明

ADC は、ADC 変換の 4 億回に 1 回程度の割合でエラーを発生する可能性があります。変換エラーが発生すると、ADC のデジタル出力にジャンプが生じ、ADC 入力電圧の対応する変化がない場合、「スパークル コード」と呼ばれます。ADC が 12 ビット分解能設定で使用されている場合、ジャンプの大きさは予想される ADC 出力に対して 64LSB 高くまたは低くなります。ジャンプの大きさは、10 ビット分解能で  $\pm 16\text{LSB}$ 、8 ビット分解能に設定すると  $\pm 4\text{LSB}$  に減少します。

#### 回避方法

ADC.DEBUG1:CTRL[10:9]ビットを High にセットすることで、1,000 億 ADC 変換のエラーレートを 1 エラーに低減できます。3 つの連続するサンプルのうち、標準偏差が最も高いものは破棄され、他の 2 つは ADC 出力を生成するために平均化されるなど、他のソフトウェアによる回避策も考慮できます。

12 ビット分解能に設定した場合、16 個の連続 ADC 出力をソフトウェアで平均化すると、ADC 出力の偏差が  $\pm 4\text{LSB}$  に減少します。

この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) の将来のリリースに組み込まれる予定です。

**BATMON\_01**      **温度測定が不正確です****影響を受けるリビジョン F****説明**

ヒステリシスが有効な場合、BATMON が不正確な温度を報告する可能性があります。誤った温度報告の可能性を防ぐため、ユーザーは常に BATMON のヒステリシスを無効にする必要があります。

**回避方法**

ヒステリシスは PMUD.CLT[2] HYST\_EN ビットによって制御されます。

ヒステリシスはデフォルトで有効 (リセット値 = 1) であり、ブート中に積極的に無効にする必要があります。

ヒステリシスは、次のコマンドを使用して PMUD.CLT[2] HYST\_EN ビットをクリアして無効にできます：

```
HWREG (PMUD_BASE + PMUD_O_CTL) = (PMUD_CTL_CALC_EN |  
PMUD_CTL_MEAS_EN)
```

この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 9.11 以降に組み込まれています。

## BATMON\_02      スタンバイ状態の **BATMON** からスプリアス温度更新割り込みが発生します。

### 影響を受けるリビジョン F

**説明**      PMUD.EVENT.TEMP\_UPDATE がスタンバイからのウェークアップ ソースとして使用されている場合、BATMON がスプリアス温度更新割り込みを発行する可能性があります。

**回避方法**      PMUD.EVENT.TEMP\_UPDATE をウェークアップ ソースとして使用する代わりに、PMUD.EVENT.TEMP\_OVER\_UL (現在の温度が設定上限を超過) または PMUD.EVENT.TEMP\_BELOW\_LL (現在の温度が設定下限を下回る) を検討してください。

PMUD.EVENT.TEMP\_OVER\_UL または PMUD.EVENT.TEMP\_BELOW\_LL をウェークアップ割り込みとして使用する場合、以下の他の設定を有効にする必要があります:

- PMCTL.VDDRCTL.SELECT を 0x0 に設定して、VDDR 調整のソースとして GLDO を選択します。

### 注

これにより、スタンバイ消費電力がわずかに増加します。詳細については、データシートの「消費電力 — 電力モード」セクションを確認してください。

- SYS0.TMUTE4.RECHCOMPREFLVL を 0x2 に設定します
- SYS0.TMUTE5.GLDOISSET を 0x1E に設定します

この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) の将来のリリースに組み込まれる予定です。

<b>SYS_204</b>	以前に値がプログラムされている場合、 <b>SysTimer</b> が比較イベントを必ずしも生成しないことがあります。
<hr/>	
<b>影響を受けるリビジョン F</b>	
<b>説明</b>	<b>SysTimer</b> に値が事前にプログラムされている場合、初期化/同期フェーズ中に比較イベントを常に生成しないことがあります。
<b>回避方法</b>	<b>SYSTIM.STATUS.SYNCUP</b> がクリアされるまで <b>SysTimer</b> のプログラミングを待ちます。この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 9.11 以降に組み込まれています。



## SYS\_206

### HFXT 振幅補償および HFXT 振幅制御中に RF 位相がジャンプします。

---

#### 影響を受けるリビジョン F

##### 説明

HFXT 振幅補償および HFXT 振幅制御中に RF 位相がジャンプします。この問題は、デバイスの起動が完了した後、HFXT を使用してプログラムでキャップ配列値を調整した場合にのみ発生します。起動時にキャップ配列値が設定されている場合、この問題は発生しません。

##### 回避方法

キャップ配列ステップの設定または変更は、起動時および RF 動作の前にのみ行ってください。その時点以降のランタイム中、キャップ配列ステップを動的に変更しないでください。Q1 および Q2 のキャップ配列ステップは SysConfig で変更できます。

**SYS\_207**

**FLTSETTLED** ビットが早すぎるタイミングで読み出されると、スタンバイ エントリがゲートされない可能性があります。

**影響を受けるリビジョン F****説明**

LFINC フィルタが安定する前にスタンバイ エントリをゲートしようとし、読み出しが早すぎる場合、スタンバイ エントリがゲートされない可能性があります。LFXT を使用している場合、この問題は発生しません。

**回避方法**

この問題を回避するために、LFOSC を使用する場合、次の手順を実行してください：

- 1.両方の割り込みをクリアします。
- 2.CKMD.RIS.HFXTGOOD を確認します。
- 3.CKMD.RIS.LFTICK を確認します。
- 4.FLTSETTLED を確認します。

LFINC フィルタが安定したときのみスタンバイ エントリをトリガしてください。これは、メモリ マスクレジスタ (MMR) CKMD.LFCLKSTAT.FLTSETTLED ビットを読み取ることで確認できます。

または、LFXT を使用してこの問題を回避できます。この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 9.11 以降に組み込まれています。

---

**APU\_201** **APU データメモリの書き込み操作が失敗します。**

---

**影響を受けるリビジョン F**

**説明** 2 つの書き込み操作が連続して行われる場合、APU データメモリの書き込み操作が失敗します。

**回避方法** 顧客は APU データメモリにアクセスする際に、常に TI APU ドライバを使用する必要があります。この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 9.11 以降に組み込まれています。

## UDMA\_01      ペリフェラルからの単一要求に対する $\mu$ DMA 書き込み応答が失われる可能性があります。

### 影響を受けるリビジョン F

#### 詳細

$\mu$ DMA はペリフェラルからの単一およびバースト要求に応答します。調停損失により  $\mu$ DMA からの書き込みアクセスが相互接続書き込みバッファに捕捉された場合、ペリフェラルが 2 番目のスプリアス単一またはバースト要求を発生する可能性があります。ペリフェラルの FIFO が以前の書き込みバッファの内容でいっぱいになった後、 $\mu$ DMA が 2 番目の要求に応答するため、2 回目の書き込みがペリフェラルに無視され、失われます。この問題は、 $\mu$ DMA TX チャンネルを介したデータ転送でのみ発生します。インターコネクトを介した読み出しパスに書き込みバッファが含まれていないため、この問題は  $\mu$ DMA RX チャンネルでは発生しません。

#### 回避方法

$\mu$ DMA SETBURST が BURST 要求を使用するように設定されています。

$\mu$ DMA 調停サイズが 2 に設定されます。

TX FIFO レベルトリガが  $\leq 1/4$  空きに設定されます。

この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 9.11 以降に組み込まれています。

## **RADIO\_05**      無線の書き込み操作が失敗します。

---

### **影響を受けるリビジョン F**

#### **詳細**

2 つの書き込み操作が連続して行われる場合、無線の書き込み操作が失敗します。

#### **回避方法**

無線とのインターフェースには、常に RCL (無線制御層) を使用する必要があります。

この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 9.11 以降に組み込まれています。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated